

拓荆科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”，涉及公司业务的相关内容，除特别说明外，含合并报表范围内的下属公司），为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，在全面总结 2025 年度行动方案成效的基础上，积极深入挖掘公司 2026 年度“提质增效”优化目标和提升举措，助力资本市场健康、稳定发展。2026 年上半年（以下简称“报告期”），该专项行动方案主要举措的实施情况及效果如下：

一、聚焦主业，优化运营，创新引领公司高质量发展

报告期内，公司继续聚焦主业，做深做精主营产品，坚持自主创新，增强公司产品的市场竞争力，并持续强化公司运营管理，促进公司高质量、稳健、快速发展，保持公司在国内高端半导体设备行业的领先地位。具体包括以下方面：

（一）持续深耕主业，提高核心竞争力

报告期内，公司持续专注薄膜沉积设备和三维集成领域设备的研发与产业化，不断拓展和提升 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备及应用于三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备（以下简称“三维集成设备”）的应用覆盖面及量产规模。随着芯片技术的迭代升级，公司先进产品量产规模不断攀升，截至报告期末，公司累计出货超过 3,800 个反应腔（包括超过 480 个新型反应腔 pX 和 Supra-D），进入约 100 条生产线。公司主要产品如下：



在薄膜沉积设备方面，公司仍持续围绕以 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 以及 Flowable CVD 为主的薄膜沉积技术深耕拓展和迭代升级，定制化开发不同类型的高产能平台和反应腔，精准满足先进制程领域对多种先进薄膜工艺的高要求。报告期内，公司已出货不同工艺的 PECVD 设备产品至海外客户端；基于反应腔 pX 和 Supra-D 研发的 PECVD Stack（ONO 叠层）、ACHM 系列工艺、OPN、SiB 等多款先进工艺设备以及 PECVD Bianca 工艺设备持续扩大量产规模，且基于 pX 反应腔开发的 α -Si 工艺设备已通过先进逻辑客户验证；公司基于原有已规模量产的 PF-300M 高产能平台开发了 PF-300L 平台，并设计了 nX、kX 等反应腔，以满足先进制程芯片对低介电常数材料的高性能指标需求，该系列产品已出货至客户端验证。公司多台 PE-ALD SiO₂、SiCO 等工艺设备通过客户验证，在先进存储客户量产规模快速攀升，同时获得了客户批量订单，且 SiO₂、SiN、SiCO、TiO 等工艺设备持续出货至客户端；Thermal-ALD 在持续拓展新工艺，多台产品出货至客户端，包括 AlN、Al₂O₃、LaO、TiON 等先进工艺。截至报告期末，公司多台 ALD 设备在客户端完成重复订单验收，量产规模持续增长。公司沟槽填充系列产品持续获得客户批量订单、出货，进一步扩大量产应用规模，其中，

SACVD PESAF 薄膜工艺设备已多台通过不同客户验证。截至报告期末，公司推出的 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 及 Flowable CVD 等薄膜设备可以支撑先进存储、先进逻辑等领域中所需的约 100 多种工艺应用。

在三维集成设备方面，公司持续拓展新产品，包括芯片对晶圆熔融键合、键合界面空洞修复等产品，同时，公司拓展了多个新客户。目前公司三维集成设备产品已覆盖先进存储、先进逻辑、图像传感器等多个领域应用，公司致力于为三维集成领域提供全面的技术解决方案。

此外，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买无锡尚积半导体科技股份有限公司（以下简称“无锡尚积”）控制权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。无锡尚积主要产品包括 PVD、CVD 工艺薄膜沉积设备与刻蚀设备，其 PVD 设备产品在功率半导体、MEMS、射频芯片等细分领域具有国内领先地位和突出市场竞争优势。本次交易将快速补齐公司核心产品线，完善对主流薄膜沉积工艺和三维集成领域关键设备的覆盖，进一步加强在半导体设备领域的战略布局。本次交易尚需取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册。

（二）深化客户合作，加强市场拓展

报告期内，公司继续聚焦中国大陆高端半导体设备市场，积极响应下游先进存储、先进逻辑等客户对新工艺、新产品的需求，加快产品开发与导入。此外，公司在开拓海外市场方面也取得了突破性成果，获得海外客户订单并出口至海外市场。

公司以良好的稳定性、高产能及优异的薄膜工艺指标等特点持续保持产品的竞争优势，公司薄膜沉积设备在客户端产线生产运行稳定性表现优异，平均机台稳定运行时间（Uptime）超过 90%（达到国际同类设备水平）。公司薄膜沉积设备系列产品在晶圆制造产线的量产应用规模快速扩大，截至报告期末，公司薄膜沉积设备在客户端产线生产产品的累计流片量约 6 亿片。此外，公司持续拓展新客户，不断扩大量产规模，截至报告期末，公司在手订单饱满，可为全年交付与业绩增长提供坚实支撑。

（三）推进再融资及募投项目实施，加速扩产和研发布局

报告期内，公司已顺利完成 2025 年度向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额为人民币 459,999.97 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,174.73 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 455,825.24 万元，用于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”、“前沿技术研发中心建设项目”及补充流动资金。上述募投项目紧密围绕公司主营业务，是现有主营业务的延伸与拓展，符合公司长期发展规划及业务布局。

截至本报告披露日，“高端半导体设备产业化基地建设项目”已完成厂房主体结构封顶，整体实施进展顺利，后续的建设会按照既定计划稳步推进，预计于 2028 年完成建设并投入使用，该项目的实施将大幅提升公司高端半导体设备产品的产能；“前沿技术研发中心建设项目”主要围绕半导体前沿技术需求开展系列薄膜设备产品开发，按计划顺利开展研发工作。

（四）优化运营管理，助力高质量发展

公司不断提升产品生产制造水平，优化物料运营管理。报告期内，公司智能化 MES 系统（生产管理系统）在保障原有操作可记录、追溯功能的基础上，结合现场生产实际痛点与一线员工业务需求持续迭代优化，已累计提出多项系统改善项目，充分发挥 MES 系统生产支撑、作业指引作用。公司使用配套数据传输系统，实现装配工序扭矩数据直传，有效保障装配作业精度。

报告期内，公司持续优化质量管理体系，打通研发、供应链、制造及服务全链条，对全流程数据进行动态监测分析，进一步强化质量管控、提升生产效率与敏捷性，保障生产经营有序开展。

此外，公司内网部署了 GPU 服务器资源，自主搭建智能 AI 办公系统，开发了智能对话与智能体工作流，实现文档生成、智能问答等工具，使用智能化工具链深度赋能日常业务，有效提升办公效率。

（五）强化供应链建设，保障供应链稳定安全

报告期内，公司持续优化供应商关系管理系统（SRM），有效提升订单响应与交付效率。同时，加强对供应商的产能管理，已形成完善的管理体系。公司通过定期/不定期开展供应商培训，每个季度核实供应商综合产能等关键指标，

并全面提升供应商质量意识，确保供应部件的交付质量。报告期内，已开展供应商培训和现场稽核 80 余次。公司持续完善和布局交付管理机制，通过安全库存，缩短物料交期，管理供应商交付等措施，确保供应稳定。

（六）加强人才队伍建设，夯实公司高质量发展根基

公司结合战略规划及业务发展需要，持续强化人才队伍建设，通过内部挖掘潜力人才、外部引进行业经验丰富的管理及技术人才、选拔优秀毕业生等方式，快速扩大人员规模。截至报告期末，公司员工总数达到 2,049 人。

报告期内，公司搭建分层分类培训体系，覆盖技术、管理等多方面，致力于培育复合型人才，为企业持续发展提供坚实人才支撑。公司已累计开展技术类、管理、通用力等培训约 130 次。此外，公司持续为员工开放继续教育学习通道，鼓励并支持员工进行在职教育。报告期内，公司共对 9 名员工提出的在职攻读 MBA（工商管理硕士）、在职研究生和博士研究生学位的申请予以支持。

（七）优化管理层与全员绩效考核，保障公司稳定发展

报告期内，公司对管理层和全员设定了 2026 年度系列绩效考核指标，覆盖公司销售业绩、盈利目标、新工艺和新产品开发验证等，有效地将管理层绩效与公司经营业绩挂钩。

此外，根据公司的长效激励机制，公司已实施 3 期限限制性股票激励计划和 1 期股票增值权激励计划，均设定了持续增长的公司业绩考核指标及激励对象个人绩效指标，公司严格按照业绩考核指标完成情况和个人绩效考核结果实施股权激励计划的归属和行权。

（八）搭建产业投资平台，拓展业务布局

报告期内，公司与沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会及其他产业合作方共同发起设立辽宁聚芯智能装备创新中心有限公司，该主体主要围绕应用于先进制程领域的高端集成电路装备新产品、新技术的需求开展关键零部件的核心技术开发、验证与应用，并搭建设备及零部件研发、测试平台，孵化相关技术实现产业化，将有效强化产业链协同创新机制，促进设备厂商、零部件供应商及应用端的深度融合。

此外，公司继续积极探索并投资半导体行业领域内的企业，持续拓展多元化投资布局，一方面，重点挖掘产业链上下游具备协同潜力的优质标的，以强化供应链；另一方面，深化与公司核心产品的战略联动，拓展产品矩阵。报告期内，公司开展了对物元半导体技术（青岛）有限公司、托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司、长鑫科技集团股份有限公司的股权投资。截至报告期末，公司及子公司已直接/间接累计投资 23 家企业，覆盖多个半导体设备产业链领域，强化产业链协同效应，提升整体业务竞争力。

（九）深化产学研融合，促进行业共同发展

报告期内，公司持续深化产学研融合，与多所高校开展多元化合作，为公司高质量发展注入新动能。

同时，公司积极提升品牌影响力，参加 SEMICON China 2026、2026 中国浙江（海宁）半导体装备及材料博览会，展示公司薄膜沉积设备、三维集成设备新产品，如 ALD VS-300T Astra-s SiN 和 PF-300T Altair TiN 等产品，设备性能先进，同时满足高产能需求，并具有优异的坪效比和 CoO（拥有成本）。此外，公司与业内专家及合作伙伴深度交流科研成果、分享技术经验、共探前沿课题，展现公司产品的产业价值，获得了广泛关注与赞誉。

（十）强化财务管理能力，真实、公允反映公司财务状况

报告期内，公司财务工作紧扣业务发展格局，全面优化预算管理体系，积极推进预算管理智能化系统上线，以实现业绩目标与预算执行更加高效的管控。公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金到账约 46 亿，使得在满足公司业务发展资金需求的同时，资金配置结构得到优化，资产负债率从报告期初的 64.1%降低至报告期末的 47.9%的合理区间。公司将持续完善风险防控机制，强化战略资源的统筹协同，为公司高质量发展提供坚实的财务支撑。

二、坚持自主创新，驱动业务发展

（一）保持高强度研发投入，持续技术创新

公司不断丰富和完善薄膜沉积设备、三维集成设备的产品矩阵和覆盖面。通过持续自主创新和高强度研发投入，保持薄膜沉积设备和三维集成设备的技术领

先优势，同时，在先进制程领域的核心竞争力显著提升，业务规模实现大幅增长。报告期内，公司研发投入金额达到 42,280.92 万元，同比增长 21.09%。

公司在新产品和新型平台研发、验证及产业化应用等方面取得的成果，详见公司 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“二、经营情况的讨论与分析”。

（二）深化知识产权管理，奠定创新基础

公司经过十余年创新发展，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，并达到国际先进水平。报告期内，公司持续完善知识产权管理体系，面向公司产品全生命周期各关键节点进行专利挖掘布局，保证技术研发和创新成果及时、高效地获得知识产权保护。报告期内，公司新增申请专利 105 项（含 PCT）、新增获得专利 87 项。截至报告期内末，公司累计申请专利 2,245 项（含 PCT）、获得授权专利 791 项。

报告期内，公司面向全员组织了系列提升知识产权能力的培训，从创新构思到风险防控及应对措施等，全面提升知识产权保护意识与应对风险的能力。同时，通过制定标准作业程序文件和相关流程，有效提升工作效率。

（三）加强研发团队建设，打造核心技术优势

公司积极吸纳行业优质研发人才，持续扩充研发团队规模、优化人才梯队结构，为公司长期技术创新与可持续发展筑牢人力资源根基。截至报告期末，公司研发人员达到 856 人，占报告期末公司员工总数的 41.78%，其中硕士以上研发人员 574 名，占研发人员比例 67.06%，研发团队专业素养与技术实力得到持续提升。

公司持续优化研发人员的创新激励机制，报告期内，公司对获得专利、商标、软件著作权等的发明人给予激励奖项，鼓励员工积极创新。

截至报告期末，公司已实施三期股权激励计划，有效调动了员工的积极性与创造性，并将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

三、重视股东回报，共享高质量发展成果

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值，报告期内，积极采取以下措施：

（一）持续现金分红，提升投资者获得感

公司高度重视股东的投资回报，在公司业务稳健发展的同时，努力为股东创造长期可持续的价值，共谋长远发展。报告期内，公司已实施 2025 年度现金分红，合计派发现金红利 92,870,288.94 元（含税）。

同时，根据《拓荆科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股（尚需股东会审议通过）。

公司将继续提升经营能力与投资回报能力，持续构建可持续的股东价值回报体系，与广大投资者共享公司经营发展成果。

（二）积极稳定股价，保障股东权益

报告期内，公司基于已建立的稳定股价措施的方案积极维护公司市值，同时，公司密切关注媒体报道、资本市场的动态讯息，监测日常舆情情况，未发生重大舆情及股价异动。公司已制定《拓荆科技股份有限公司市值管理制度》《拓荆科技股份有限公司舆情管理制度》，及时、妥善处理各类舆情的影响，切实保护投资者和公司的合法权益。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

报告期内，公司高度重视信息披露及投资者交流工作。信息披露方面，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司于 2026 年 4 月 28 日披露 2025 年年度报告，并于同日披露 2026 年第一季度报告，同时，采用可视化长图解读公司重大成果和进展，并在公司公众号发布，使投资者能清晰、及时、

充分、公平地了解公司情况。

在投资者关系方面，公司通过投资者热线、上证 e 互动平台、业绩说明会等渠道，保持与投资者沟通交流，充分回应市场关切，传递企业经营内在价值。同时，公司积极参加投资者交流会。截至本报告披露日，公司召开了 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司董事、高级管理人员积极参与，通过视频直播、网络文字互动的形式，与投资者就经营成果、财务状况等进行沟通交流。报告期内，公司通过接待投资者现场调研、参加券商策略会、反路演等多种形式，与投资者交流 90 余次，增进投资者对公司的了解与信任，树立良好的资本市场形象。

五、坚持规范运作，强化公司治理

公司不断健全优化治理结构和内部控制体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

（一）完善治理制度，加强风险防范

报告期内，公司共召开股东会 2 次、董事会 4 次、董事会审计委员会 2 次、董事会薪酬与考核委员会 1 次、董事会提名委员会 1 次、董事会战略规划委员会 1 次及独立董事专门会议 2 次，所有审议议案均 100% 获得通过。董事会及各专门委员会、独立董事、管理层认真履职，切实保障公司及中小股东利益。

公司依据《上市公司治理准则》修订并披露了《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》，明确了薪酬管理遵循的原则，确定了薪酬构成与标准，建立了薪酬止付追索等约束机制。该制度的出台，使公司管理层利益与股东利益、公司长期发展实现更紧密的绑定，为激发管理层活力、提升运营效率提供了制度保障。

（二）强化“关键少数”责任，提升履职能力

报告期内，公司组织董事、高级管理人员和相关人员参加学习辽宁辖区上市公司规范运作培训会、上市公司高质量发展系列培训、2026 年沪市上市公司信息披露与交易监管联动专项培训等相关培训共计 6 次，增强合规意识和履职能力，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。同时，公司持续强化信息披露、合规交易及内幕信息管理等方面的传导与宣贯，不断提升相关人员

的责任意识与自律意识。

（三）构建 ESG 体系，促进可持续发展

报告期内，公司持续完善 ESG（环境、社会及公司治理）体系，凭借在可持续发展方面的优异表现，被多项重要主题指数纳入覆盖范围。在评级方面，截至本报告披露日，公司 MSCI（摩根士丹利资本国际，Morgan Stanley Capital International）ESG 评级提升至“A”级，Wind ESG 评级提升至“AAA”级，华证指数 ESG 评级提升至“AA”级，系统反映了公司在可持续发展领域的实践与绩效。在荣誉方面，公司凭借在 ESG 方面的综合实力表现，荣获“SEMI ESG 特别贡献奖”、2026 证券之星“ESG 新标杆企业奖”、“华证 2026 年省级区域 A 股上市公司 ESG 优质企业名单”。

报告期内，公司坚持将 ESG 发展理念深度融入公司经营管理中。在环境方面，公司持续深化绿色转型发展，多个厂区通过外购电力与可再生能源配置相结合，持续优化公司能源利用结构；公司在上海的厂区屋顶光伏系统已全部启用，所发电量全部应用于生产办公；公司开展“安全生产月”主题活动、消防演练，不断强化全员安全意识；在社会方面，公司持续提供高质量的产品及服务，并加强上游供应链的管理，同时，践行公益初心，通过公益捐赠项目，主动承担社会责任，助力社会和谐、可持续发展；在治理方面，公司持续深化 ESG 治理体系建设，通过完善 ESG 实施目标、明确 ESG 执行小组职责等方式，积极推动 ESG 战略落地。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日